

杭州士兰微电子股份有限公司 对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开的第八届董事会第二十四次会议和 2024 年 6 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议〉的议案》。

公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦门新翼科技实业有限公司于 2024 年 5 月 21 日在厦门市签署了《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。《投资合作协议》获相关权力机关批准后已生效。

根据《投资合作协议》，各方合作在厦门市海沧区合资经营项目公司“厦门士兰集宏半导体有限公司（以下简称“士兰集宏”或“项目公司”）”，以项目公司负责作为项目主体建设一条以 SiC-MOSFET 为主要产品的 8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线，一期产能规模 3.5 万片/月。根据《投资合作协议》，士兰集宏拟新增注册资本 41.50 亿元（以下简称“本次增资”），由本公司、厦门半导体投资集团有限公司和厦门新翼科技实业有限公司以货币方式共同认缴，其中：本公司认缴 10 亿元，厦门半导体投资集团有限公司认缴 10 亿元，厦门新翼科技实业有限公司认缴 21.50 亿元；本次增资无溢价。公司及协议各方在按照《投资合作协议》完成第一期项目的投资后，士兰集宏的注册资本将由 0.60 亿元增加至 42.10 亿元，公司对士兰集宏的持股比例将由 100%降低至 25.1781%，公司将不再将其纳入合并报表范围，将按照权益法核算对士兰集宏的投资，并按照持股比例 25.1781%计算确认投资收益。

上述事项详见公司于 2024 年 5 月 22 日、5 月 23 日和 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号：临 2024-042、临 2024-044、临 2024-048。

二、对外投资进展情况

根据《投资合作协议》，本公司与厦门半导体投资集团有限公司已分别认缴士兰集宏本次新增注册资本 10 亿元，士兰集宏注册资本由 0.60 亿元增加至 20.60 亿元。士兰集宏已于近日办理完成相应的工商变更登记。截至本公告披露日，士兰集宏最新的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
厦门半导体投资集团有限公司	100,000	48.54	货币
杭州士兰微电子股份有限公司	106,000	51.46	货币
合计	206,000	100.00	-

根据士兰集宏最新的股权结构，公司对士兰集宏的持股比例由 100%降低至 51.46%，士兰集宏仍为公司的控股子公司。目前，厦门新翼科技实业有限公司出资相关程序尚未完成，其正在积极推进中，待其按照《投资合作协议》完成 21.50 亿元的认缴后，士兰集宏的注册资本将由 20.60 亿元增加至 42.10 亿元，公司对士兰集宏的持股比例将由 51.46%降低至 25.1781%，公司将不再将其纳入合并报表范围，将按照权益法核算对士兰集宏的投资，并按照持股比例 25.1781%计算确认投资收益。

公司将继续推动厦门新翼科技实业有限公司尽快完成认缴事项，并推动各方资本金的实缴到位，加快士兰集宏“8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目”的建设。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日